



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 03-07-2012 12:45

## Vapor Chamber per il nuovo TPC 800 di Cooler Master



**Make It Yours.**

**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/raffreddamento-aria/4762/vapor-chamber-per-il-nuovo-tpc-800-di-cooler-master.htm>)**

Finalmente disponibile l'innovativo dissipatore Cooler Master con tecnologia Vertical Vapor Chamber.



↔

Dopo aver presentato il primo dissipatore dotato di heatpipes ben 12 anni fa, **Cooler Master** annuncia la disponibilità a scaffale del modello **TPC 800**, il primo dissipatore per CPU dotato di tecnologia **Vertical Vapor Chamber**, una tecnologia originariamente sviluppata dalla divisione OEM industriale di **Cooler Master** diretta derivazione delle soluzioni utilizzate per il raffreddamento delle schede video ad alte prestazioni.

↔





↔

Il **TPC 800**, grazie alle sue doppie "Vertical Vapor Chamber", è in grado di raggiungere prestazioni al Top e quindi di raffreddare efficacemente i bollenti spiriti dei processori multi core di ultima generazione sia AMD che Intel.↔

↔



↔

Tecnicamente la **Vertical Vapor Chamber** distribuisce il calore in maniera uniforme sull'intera superficie dissipante, evitando un eventuale collasso termico e consentendo, allo stesso tempo, una diminuzione del 50% della resistenza dell'aria, riducendo così i vortici ed abbattendo conseguentemente il rumore generato dai flussi di aria che attraversano il dissipatore.

Allo stesso tempo, le **Vertical Vapor Chambers** aumentano di ben 3 volte la superficie di contatto delle lamelle, consentendo un più rapido ed efficiente trasferimento del calore dalla "camera del vapore" alle lamelle stesse con un utilizzo migliore della loro superficie dissipante.

↔



↔

La base in rame puro al 100% lucidata a specchio, combinata con un lo speciale design del dissipatore, un sistema di montaggio della ventola semplificato ed un miglioramento delle tecniche di saldatura a rifusione, sono tutte caratteristiche in grado di incrementare sensibilmente le capacità di dissipazione del calore, rendendo il **TPC 800** in alcuni casi migliore dei sistemi All-In-One a liquido sigillato attualmente sul mercato.

↔



↔

Il **TPC 800** sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dalla fine del mese di luglio ad un prezzo al pubblico consigliato di 64 €, - IVA inclusa.

↔

**Specifiche tecniche**

Modello	<b>TPC 800</b>
CPU Socket	Intel↔® LGA 2011/1366/1156/1155/775 AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Dimensioni	134 x 74 x 158 mm (5.3 x 2.9 x 6.2 in)
Materiale corpo dissipante	Rame per la base, le due Vapor Chamber e le sei heatpipes Alluminio per le alette ↔
Peso	826g (1.83 lb)
Dimensioni heatpipes	à ~6mm

↔

## COMUNICATO STAMPA

↔

↔